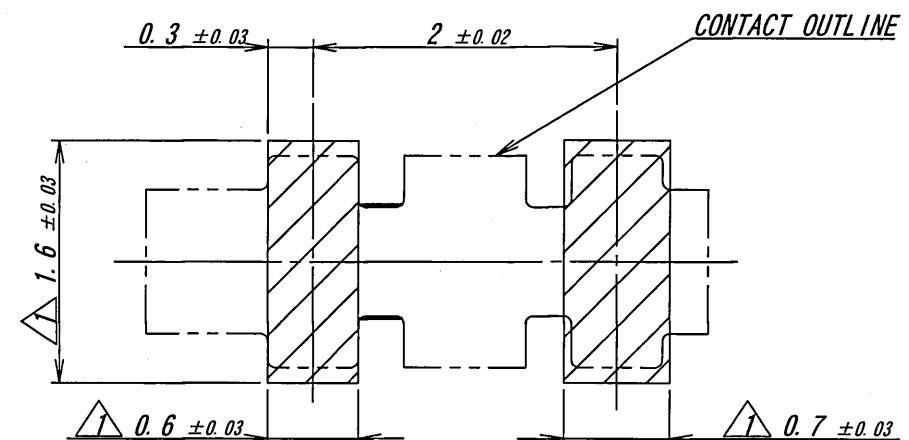
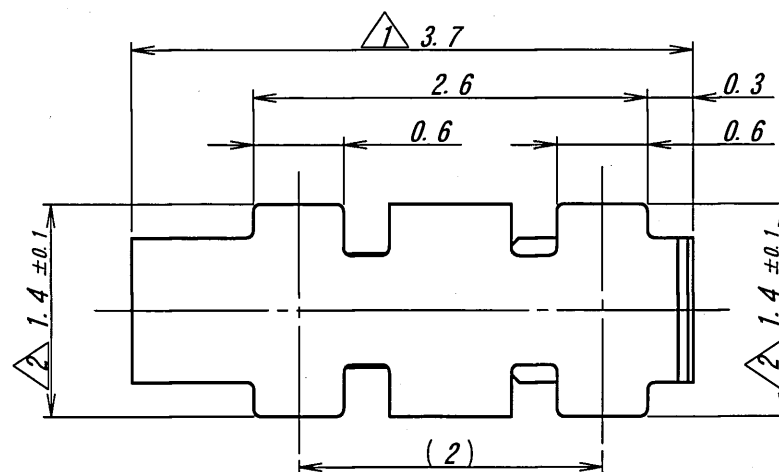
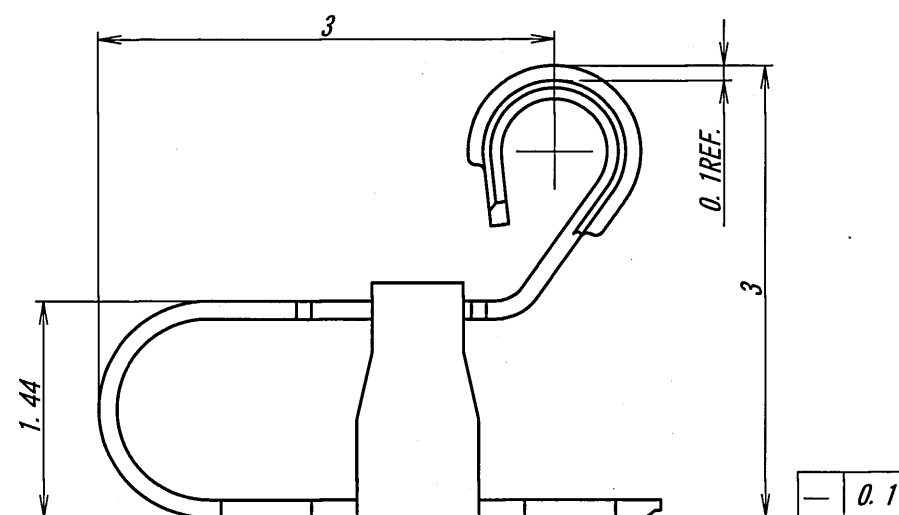
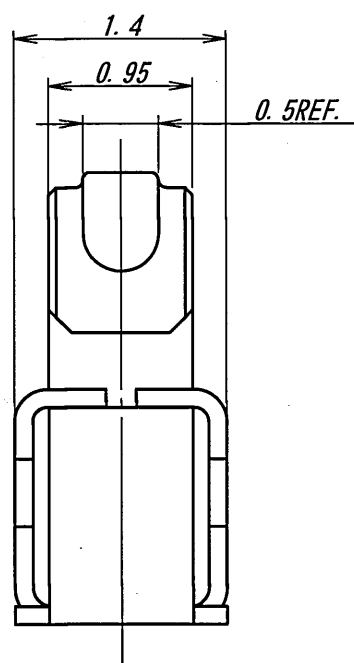
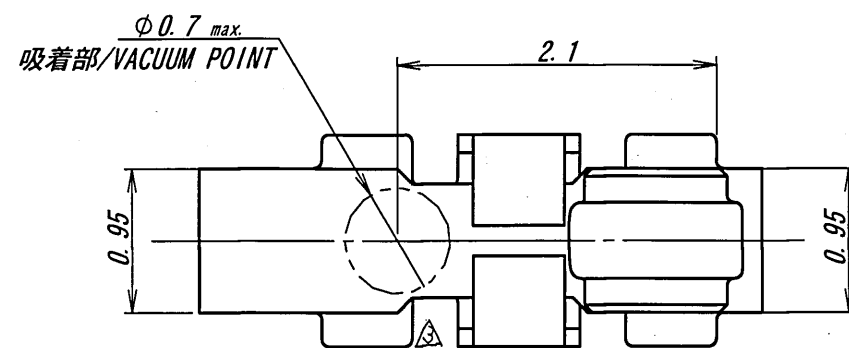
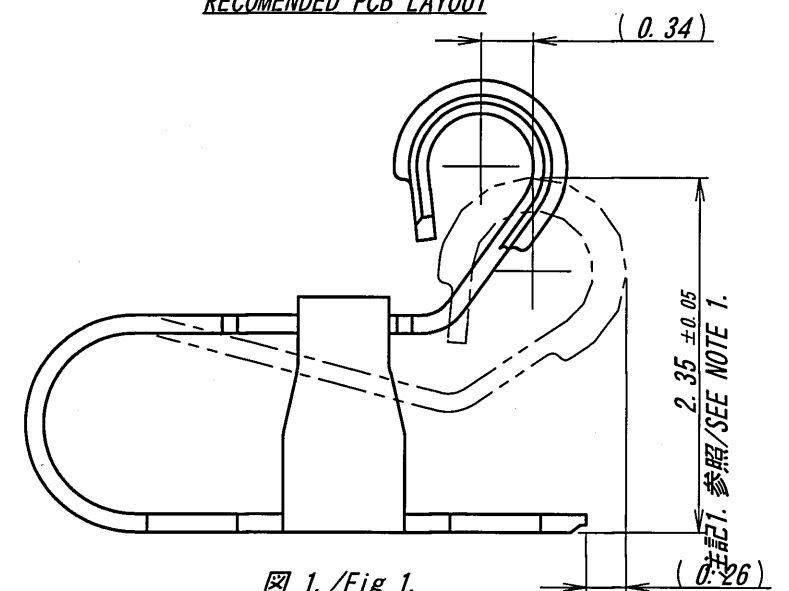


A B C D E F G H



推奨基板図
RECOMMENDED PCB LAYOUT



注記/NOTES

1. 使用圧縮範囲: 接点位置 2. 35mm ±0.05 図1. 参照
USE COMPRESSION LOCATION: CONTACT POINT 2. 35mm ±0.05 SEE Fig 1.
2. 荷重: 60 ±15gf
CONTACT FORCE: 60 ±15gf

表 1./TABLE 1.

製品番号/PART No.	めっき仕様/FINISHED	貴社型番/CUSTOMER PART No.
4063T-01B-GF	前めっき/PRE-PLATE 下地めっき/UNDER PLATED: Ni 接点部/CONTACT POINT: Au 半田付け部/SOLDER AREA: Au	
4063T-01B-TN	前めっき/PRE-PLATE 下地めっき/UNDER PLATED: Ni 接点部/CONTACT POINT: Ni 半田付け部/SOLDER AREA: Sn	

△						MATERIAL 材質	GENERAL TOLERANCES 一般公差	SCALE 尺度	N/A	UNIT 単位	mm	TITLE 名称	4063シリーズ コンタクト SERIES 4063 CONTACT	
△						端子 : リン青銅 (t=0.12) CONTACT : PHOSPHOR BRONZE (t=0.12)	DIM 寸法 ± 0.2	DR	K. Chiba	DSN	K. Chiba	EDP No		
△							ANGLE 角度 ±	CHK	6-3-8 Jooof	APP	061318	PARTS No 部番	4063T-01B-**	
△							3RD. ANG. PROJ. 三角法	IRISO ELECTRONICS CO., LTD		DWG No 図番		1PS-4063T-01B-**		REV.
△	25127	REVISED	K. C	4.5	'06/3/8	表 1. 参照/SEE TABLE 1.		IRISO 電子工業株式会社						3
△	24620	REVISED	K. C	4.5	'06/1/13									
△	+	REVISED	K. C	4.5	'06/1/10									
△	+	RELEASED	K. C	4.5	'05/12/26									
LTR 記号	ECN No	REVISION RECORD 記	DR	CHK	DATE 年月日									